

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2018-60

广东风华高新科技股份有限公司 关于投资新增月产 56 亿只 MLCC 技改扩产项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

（一）根据公司战略发展规划，并结合电子元器件市场发展趋势及公司主营产品 MLCC（片式电容器）经营情况，为持续提升公司 MLCC 产能规模及优化产品结构，提升市场竞争力，公司投资 45,320 万元用于实施新增月产 56 亿只 MLCC 技改扩产项目（以下简称“技改项目投资”）。

（二）公司于 2018 年 8 月 29 日召开第八届董事会 2018 年第八次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司投资新增月产 56 亿只 MLCC 技改扩产项目的议案》。

（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次投资不构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。

二、本次技改项目投资主要内容

（一）项目名称：新增月产 56 亿只 MLCC 技改扩产项目。

（二）项目承建单位：公司冠华片式电容器分公司。

(三) 投资金额：项目投资总额为 45,320.00 万元，其中：新增建设投资 43,500.00 万元，建设期利息 500.00 万元，铺底流动资金 1,320.00 万元。

(四) 资金来源：公司自筹解决。

(五) 项目建设目标：新增 MLCC 产能 56 亿只/月。

(六) 项目建设期：2018 年 1 月至 2019 年 12 月。

(七) 主要经济指标测算：项目达产后，第一年预计新增营业收入 31,587.30 万元，实现净利润 5,888.10 万元；项目税前财务内部收益率为 14.41%、税前投资回收期约为 6.50 年(静态)。

三、投资目的

公司的战略目标为持续围绕做优做强做大主业，致力于成为国际一流的电子信息基础产品整合配套供应商及解决方案提供商。近两年，我国半导体产业保持高速增长，同时受部分国际先进同行重点发展方向转移影响，国内电子元器件行业市场需求旺盛，部分同行均已积极布局扩产。虽然公司的产能规模一直处于持续扩张水平，但受制于产能规模，公司 MLCC 目前的交货量和交货速度仍未能满足市场订单需求。

本次投资旨在通过持续优化产品结构调整，加快产能规模扩张和技术水平提升，确保公司中长期战略规划顺利实施以及公司的行业竞争地位。

四、投资风险、对策及对公司的影响

(一) 财务风险

技改项目投资的财务风险主要来自于国际同行的同步扩产导致公司产品市场开拓跟不上产能提升幅度，从而影响盈利水平。公司将结合市场发展趋势分阶段投入设备，逐步提升设备产能，同步扩张市场，密切关注市场占有率提升程度，确保设备利用率最大化；积极开拓市场，确保市场开拓与产能扩张同步。

（二）市场风险

技改项目投资的市场风险主要来自于现有客户需求不足、市场竞争加剧、新领域开拓困难三个方面。公司将通过持续巩固并扩大原有市场份额、积极拓展新的市场渠道等积极化解市场风险。

（三）原材料供应风险

技改项目投资的原材料供应风险主要在于原材料供应商产能未能满足行业产能扩张从而影响项目产能发挥。公司将持续加大与战略供应商的合作，积极推进战略供应商新生产基地和生产线的建设，确保主要原材料供应的稳定。

五、备查文件

公司第八届董事会 2018 年第八次会议决议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 31 日